

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2026-035

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于拟申请统一注册债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过 15 亿元人民币的统一注册债务融资工具。现将有关情况公告如下：

一、发行方案

（一）发行规模：统一注册债务融资工具额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

（二）发行期限：具体发行期限以公司在市场交易商协会注册的期限为准。

（三）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会批准的有效期内分期发行。

（四）发行利率：公司与主承销商按照市场情况协商确定。

（五）承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（六）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

（七）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效、有序地办理本次统一注册债务融资工具的相关工作，根据《中华人民共和国证券法》、《公司法》等法律法规及规范性文件等规定，提请股东会授权公司经营管理层全权办理与公司本次统一注册债务融资工具的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整统一注册债务融资工具的具体方案，以及修订、调整本次统一注册债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；

2、制定、批准、签署、修改、公告与本次统一注册债务融资工具有关的各项法律文件，并根据主管机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

3、如主管机关对统一注册债务融资工具的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会决定的事项外，对与本次申请发行统一注册债务融资工具有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行统一注册债务融资工具的注册发行工作；

4、办理与本次统一注册债务融资工具发行及上市流通相关的事宜；

5、决定聘请参与本次统一注册债务融资工具发行相关的必要的中介机构；

6、办理与本次统一注册债务融资工具发行相关的其他事项；

7、本次授权有效期限为自股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次申请统一注册债务融资工具事项已经 2026 年 5 月 18 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，债务融资工具尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

四、本次申请注册发行对公司的影响

本次申请发行债务融资工具有助于满足公司资金需求，拓宽融资渠道，降低

融资成本，促进公司经营发展；本次申请注册发行对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。

本次债务融资工具注册发行事宜尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露债务融资工具注册发行的情况。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026年5月19日